

证券代码：688396

证券简称：华润微

华润微电子有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

报告期内，公司业务专注于新一代信息技术行业中的半导体行业。产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

半导体行业是国民经济支柱性行业之一，是信息技术产业的重要组成部分，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。目前，半导体行业实现自主可控已成为社会共识与努力方向，提升中高端集成电路国产化水平已成为实施创新驱动发展战略、促进我国经济高质量发展的重要战略目标。

二、本次募集资金投向方案

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	华润微功率半导体封测基地项目	420,000.00	380,000.00

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
2	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		540,000.00	500,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。

（一）募集资金的运用情况

1、华润微功率半导体封测基地项目

（1）项目基本情况

公司立足于向综合一体化的产品公司转型的战略规划，围绕在功率半导体领域的核心优势，满足功率半导体封测领域不断增长的需求，公司计划集中整合现有功率半导体封装测试资源，在重庆西永微电子产业园区新建功率半导体封测基地，进一步提升在封装测试环节的工艺技术与制造能力。

华润微电子功率半导体封测基地建设项目总占地面积约 100 亩，规划总建筑面积约 12 万m²。本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 420,000 万元，拟投入募集资金 380,000 万元，其余所需资金通过自筹解决。

本项目建成并达产后，主要用于封装测试标准功率半导体产品、先进面板级功率产品、特色功率半导体产品；生产产品主要应用于消费电子、工业控制、汽车电子、5G、AIOT 等新基建领域。

（2）实施背景及必要性

①功率半导体市场持续发展，国产替代进程不断加速

功率半导体广泛应用于电子器件中，是电能转换与电路控制的核心，广泛服务于消费、工业、汽车及通信等场景。近年来，得益于工业自动化、可再生能源及电动汽车的蓬勃发展，工业及汽车的电动化已成为了世界功率半导体行业最具

潜力的成长动能。根据 Omda 统计，2021 年全球功率半导体市场规模预计将达到 441 亿美元，保持稳定增长。中国是全球最大的功率半导体消费国，根据 Omda 统计，2021 年中国功率半导体市场需求规模达到 159 亿美元，占全球市场比例高达 36%，具有广阔的国产替代空间。随着国家政策为大陆半导体行业创造了良好的发展环境及半导体产业重心向中国的转移，中国功率半导体行业有望率先实现国产替代，进入高速发展的黄金时期。中国功率半导体企业有望在消费电子、工业控制、汽车电子等领域实现依次突破，国产替代进程正不断加速。

随着功率半导体市场的持续发展与国产替代进程的加速，华润微功率半导体封测基地项目有助于公司深耕中国市场机会，具有广阔的市场前景。

②满足业务发展需要，践行公司战略规划，提升公司综合竞争力

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业。功率半导体是公司最具竞争力的产品领域，是公司战略聚焦的重点。

功率半导体的高可靠性是产品竞争力的重要体现，随着功率半导体行业的发展，封装技术在功率半导体产业链中重要性日益显现，封测环节价值占比较数字集成电路产业链更高。公司计划集中整合现有功率半导体封测资源，围绕标准功率半导体产品、先进面板级功率产品、特殊应用的功率半导体产品三大工艺平台，覆盖消费电子、工业控制、汽车电子、5G、AIOT 等新基建领域，建设功率半导体封装基地，以巩固并进一步提升公司在功率半导体领域的领先地位。

华润微功率半导体封测基地项目的实施，短期内可直接提升公司在功率半导体领域及封装测试环节的制造能力，使公司生产能力与业务发展相匹配，进而把握住在该领域巨大的市场机遇，带动公司产品与方案、制造与服务两大板块的收入提升；中长期则有助于公司全产业链一体化运营能力的提升，使公司能加快向综合一体化公司转型的战略方向，提升公司在功率半导体领域的综合竞争力，为公司实现成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商的愿景打下坚实基础。

（3）项目实施能力与可行性

①国家政策支持为项目落地及产业发展创造良好生态环境

半导体行业的发展程度是国家科技实力的重要体现，是信息化社会的支柱产业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。发展我国半导体相关产业，是我国成为世界制造强国的必经之路。近年来，国家各部门持续出台了一系列优惠政策来鼓励和支持集成电路行业发展。2014 年，国务院等部委颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2020 年 8 月 4 日，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境。

半导体产业建设项目需要前期较大的资金投入，具有资本密集型特征。国家政策的大力支持与社会各界对半导体行业的日益重视为华润微功率半导体封测基地项目的落地建设营造了良好的产业生态环境。

②公司在功率半导体产品及封装测试环节具备深厚的项目实施基础

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。公司是中国本土领先的以 IDM 模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。

在功率半导体领域，公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。根据 Omida 统计，公司是国内营业收入最大、产品系列最全的 MOSFET 厂商。公司合计拥有 1,100 余项分立器件产品与 500 余项 IC 产品。在封装测试领域，公司在江苏、广东、重庆等地拥有多条半导体封装测试生产线。公司封装测试生产线具有完备的半导体封装生产工艺及模拟、数字、混合信号等多类半导体测试生产工艺，在发展传统封测技术的基础上，致力于先进封装技术的研究与开发，目前在面板级封装等先进封装领域已具备一定的技术积累。

同时，公司覆盖了庞大且高粘性的客户基础。公司客户覆盖工业、汽车、消

费电子、通信等多个终端领域，客户基础庞大多元。公司秉承本土化、差异化的经营理念，深刻理解不同专业应用领域用户的需求，能够为客户提供专业、高效、优质且性价比较高的产品及服务，保证了较高的客户粘性。公司目前已积累了世界知名的国内外客户群，产品及方案被不同终端领域广泛应用，市场认可度高。同时，公司亦为国内外知名半导体企业提供制造及服务支持。公司与众多客户拥有多年的合作经验，长期以来与之共同成长，通过产品工艺的共同开发与客户积累了深厚且紧密的合作关系。

公司多年深耕功率半导体领域，并通过内生发展与外延并购不断增强在封装测试环节的工艺技术能力。公司的行业经验、技术积累、人才储备、市场资源为华润微功率半导体封测基地项目的实施奠定了坚实的基础。

（4）项目实施主体与投资情况

本项目将由公司全资子公司华微控股在重庆西永微电子产业园区新设立全资子公司作为实施主体，本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 420,000 万元，拟投入募集资金 380,000 万元，其余所需资金通过自筹解决。

（5）项目用地、涉及的审批、备案事项

公司已就华润微功率半导体封测基地项目与重庆西永综合保税区管理委员会签署了意向协议，约定项目用地选址地块位于重庆西永微电子产业园区内，土地面积预计约 100 亩，规划总建筑面积约 12 万 m²。前述用地公司将在履行招拍挂等必要程序后正式取得土地使用权。

截至本说明出具日，本项目已完成可行性研究报告编制，正在准备办理项目备案的相关工作。

截至本说明出具日，公司正在编制环境影响评价报告，将于上述项目进入建设阶段前取得环评批复。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司本次发行股票，拟使用募集资金 120,000 万元用于补充流动资金。本公

公司以实际经营情况为基础，综合考虑了公司现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，适量补充流动资金，以降低公司资产负债率、优化资本结构并满足公司未来经营发展需求。

2、补充流动资金的必要性分析

（1）为公司规模的增长提供重要的流动资金保障

半导体行业企业为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。半导体行业发展变化日新月异，技术迭代迅速。作为全产业链企业，公司为紧跟下游行业变化趋势，基于自身长期以来的设计与工艺沉淀，持续依靠核心技术推出领先的功率半导体产品与工艺平台，并积极布局智能传感器、化合物半导体等领域。

随着公司业务规模持续扩张，公司的产能会持续增加，自主设计、生产销售的产品规模与品种也在不断扩大，公司流动资金的需求将不断加大。通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司在生产及研发等经营活动的稳步投入，为公司经营能力的持续提升提供有力的流动资金保障。

（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力

半导体行业是资金密集型行业，具有较强的周期性的特征。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保障公司的持续、稳定发展。

3、补充流动资金的可行性分析

（1）募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，提升公司在技术、生产等方面的市场竞争力，长期看将有利于增强公司持续盈利能力。

(2) 募集资金管理与运用相关的内控制度完善

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域

1、本次募集资金主要投向科技创新领域

公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目为华润微功率半导体封测基地项目及补充流动资金。本次募投项目旨在提升公司在功率半导体领域及封装测试环节的工艺技术能力和科技创新水平，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

2、募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

通过募投项目的实施，公司将提升在功率半导体领域及封装测试环节的工艺技术能力与科技创新水平，持续提升公司的科技创新实力。

对于功率半导体等产品，其科技创新是一项综合性的技术活动，涉及到产品设计端与制造端研发多个产业链环节的综合创新，IDM 模式经营的企业在研发与生产各环节的积累会更为深厚，更利于技术的积淀和产品群的形成与升级。华润微功率半导体封测基地项目的建设，将有助于进一步提升更好发挥资源的内部整合优势，提高运营管理效率，根据客户需求进行更高效、灵活的特色工艺定制，形成更为丰富的产品服务组合和先进特色化的后道制造工艺。

未来公司将围绕自身的核心优势、强化核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型，矢志成为中国半导体行业的领军企业，并最终成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示两项募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2020 年 10 月 20 日